

**USB3.1C S1H DN1 RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	OMNIMATE-data - USB-uttag, USB-uttag, 10 Gbit/s, SMD-lödslutning, 90°, ≥ 10000, Delning i mm (P): 0.50 mm, Antal poler: 24, LCP, svart, Rulle
Art.nr.	<a href="#">2987560000</a>
Typ	USB3.1C S1H DN1 RL
GTIN (EAN)	4099986855052
Förp.	1 050 Stück
Förpackning	Rulle

Skapandedatum den 1 juni 2024 18:12:55 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	7,9 mm	Byggdjup (tum)	0,311 inch
Höjd	3,21 mm	Bygghöjd (tum)	0,126 inch
Bredd	8,94 mm	Byggbredd (tum)	0,352 inch
Nettovikt	10 g		

## Systemspecifikationer

Anslutningsvinkel	90°	Antal lödstift per pol	1
Antal poler	24	Avskärmning	360° Skärmkontaktering
Delning i mm (P)	0,5 mm	Delning i tum (P)	0,02 "
Effektkategori	10 Gbit/s	Lödstiftlängd (l)	1,15 mm
Lödprocess	Reflow-lödning, Manuell lödning	Montering på kretskortet	SMD-lödanslutning
Produktfamilj	OMNIMATE-data - USB-uttag	Skärmmaterial	Mässing
Skyddsklass	IP20	Skärmarea	förnicklad
Skärmflikar	ingen	Stickcykler	≥ 10000
Ändplatta, Egenskap	Ingen	Överföringshastighet	10 Gbit/s

## Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	≥ 100 MΩ	Märkspänning	5 V
Spänningstålighet kontakt/kontakt	750 V AC		

## Packaging

Förpackning	Rulle	VPE-längd	0
VPE-bredd	0	VPE-höjd	0

## Materialdata

Isoleringsmaterial	LCP	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Isolationshållfasthet	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kontaktgrundmaterial	Kopparlegering	Kontaktmaterial	Guld över nickel
Kontaktyta	Guld över nickel	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Driftstemperatur, max	80 °C		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01		

## Nedladdningar

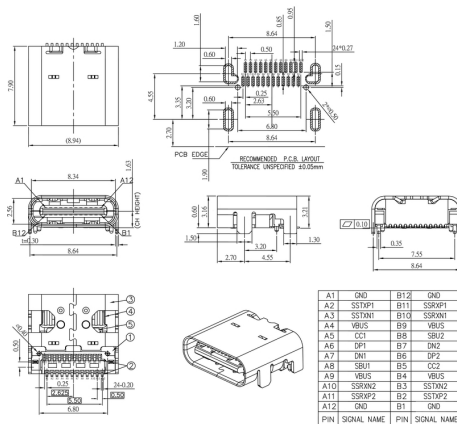
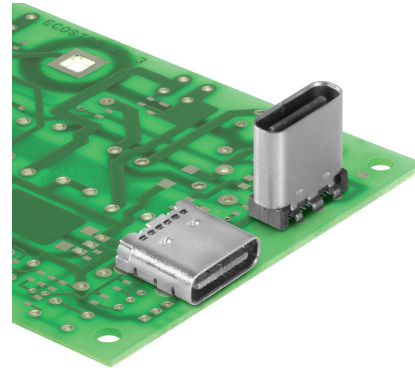
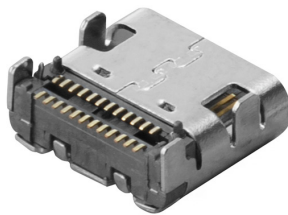
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## USB3.1C S1H DN1 RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



## Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.